

贝格斯GapFiller2000 CPU显卡LED灯具风扇散热膏

产品名称	贝格斯GapFiller2000 CPU显卡LED灯具风扇散热膏
公司名称	合肥高志电子科技有限公司
价格	385.00/支
规格参数	品牌:贝格斯 型号:GapFiller200 导热系数:2.0W/m-k
公司地址	安徽省合肥市高新区桃花智谷创业园6栋102室
联系电话	13856014258 13856014258

产品详情

Bergquist GapFiller2000双组分液态间隙填充导热材料

材料命名规则：Gap Filler 2000= GAP FILLER TGF 2000

GapFiller2000(GAP FILLER TGF 2000)可供规格：

规格(Specifications): 50CC/400CC/1200CC/10galon

导热系数(Thermal Conductivity)：2.0W/m-k

基材(Reinforcement Carrier)：硅胶

胶面(Glue)：无

颜色(Color)：粉红色/白色

持续使用温度 (Continuous Use Temp)：-60 ° ~200 °

密度 (Density) :2.9g/cc

GapFiller2000应用材料特性：

GapFiller2000为易碎元器件和低压力应用而设计,室温固化,可加速固化期,没有固化后副产物,良好的高低温机械和化学稳定性

GapFiller2000材料说明：

GapFiller2000是一款液态间隙填充导热材料，该材料为双组分，在室温或加热情况下固化，固化产物是一种柔软、导热、就地成形的弹性体，很适合用来连接安装在PC主板上的发热元器件和相接触的金属构件或散热器，固化前GapFiller2000像硅脂一样施以压力就可以流动，固化后在循环的作用下不会从界面上脱落下来，摸起来也是干的，也有别于导热间隙填充垫片，这种液态的材料能够满足各种不同的间隙厚度，可以解决应用中对厚度和模切形状的需求。GapFiller2000适用于不需要很强结构的导热界面场合。

GapFiller2000典型应用：

汽车电子，电脑和周边，通讯设备，导热防震缓冲，在产生热量的半导体和散热器之间